



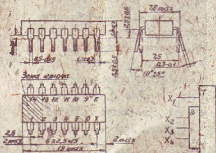
Пастарт

Микросхема КИТКЗН

Частные технические условия 0308.019ТУ2, ред.1-72

Функциональное назначение - триггер Т-К с логикой на входе "ЗИ"

Таблица 1



Выход	Назначение
1	
2	Вход установки "0" X ₁
3	Вход X ₂ (J ₁)
4	Вход X ₃ (J ₂)
5	Вход X ₄ (J ₃)
6	Выход Y ₂
7	Общий
8	Выход Y ₁
9	Вход X ₆ (K ₁)
10	Вход X ₇ (K ₂)
11	Вход X ₈ (K ₃)
12	Вход синхронизации X ₅
13	Вход установки "1" X ₉
14	Питание



$Y_0 = Y_1$ Y_{ип} - состояние логического элемента до прихода импульса синхронизации
 Y_{ип} - состояние логического элемента после прихода импульса синхронизации

Вес микросхем не более 1 г
 таблица 2

Вход X ₂ , X ₃ , X ₄	Вход X ₆ , X ₇ , X ₈	Вход X ₉	Выход Y _{ип} + 1
0	0	0	Y _{ип}
1	0	1	1
0	1	0	0
1	1	1	Y _{ип}

Напряжение питания +5В ± 5%

Содержание золота в одной микросхеме 0,00712 г

Электрические параметры при температуре +20 ± 5°C

Таблица 3

Наименование	Норма
Нагрузочная способность, И	10
Выходное напряжение, лог1 на выходе U _{вых1} , В, не более	0,4
Выходное напряжение, лог0 на выходе U _{вых0} , В, не менее	2,5

Предельно-допустимые условия эксплуатации

Диапазон рабочих температур от минус 10°С до 90°С

Предельно-допустимое кратковременное напряжение питания не более 76 в течение времени до 5 миллисекунд.

Срок хранения - 3 года.

Время гарантийной наработки.

Гарантируется соответствие микросхем требованиям технических условий при наработке 5000 часов.

Гарантии исчисляются со дня приемки микросхем представителем ОТК.

Указания и рекомендации по монтажу и эксплуатации.

Крепление микросхем к печатной плате в аппаратуре может быть произведено методом пайки выводов.

Расстояние от места пайки вывода до корпуса микросхемы должно быть не менее 2,5 мм.

Пайку выводов следует производить с принятым мер, исключающих повреждение микросхем из-за перегрева и механических усилий. При пайке рекомендуется применять припой ПОС-61 ГОСТ 1439-70 и флюс ФКС_n по НО.054.063.

При пайке с помощью паяльника, последний должен быть обязательно заземлен и иметь мощность не более 60 Вт.

При пайке температура не должна превышать 260°С, а время воздействия этой температуры на микросхемы 5 сек.

После монтажа микросхемы должны быть защищены в соответствии с нормалью НО.054.021.

С целью повышения надежности аппаратуры рекомендуется применять меры, обеспечивающие минимальную температуру нагрева корпуса микросхем и защиту от воздействия климатических факторов.

При ремонте аппаратуры замену микросхемы необходимо производить только при отключенных источниках питания.

Дата выпуска ПЕК 1976

Представитель ОТК — ОТК №5